

## INVESTOR RELATIONS

20년 상반기 (1H 20)

Your Most trustworthy



## 유의사항 [Disclaimer]

본 자료는 한국채택국제회계기준 연결실적에 대한 경영실적 및 재무성과를 바탕으로 작성되었습니다.

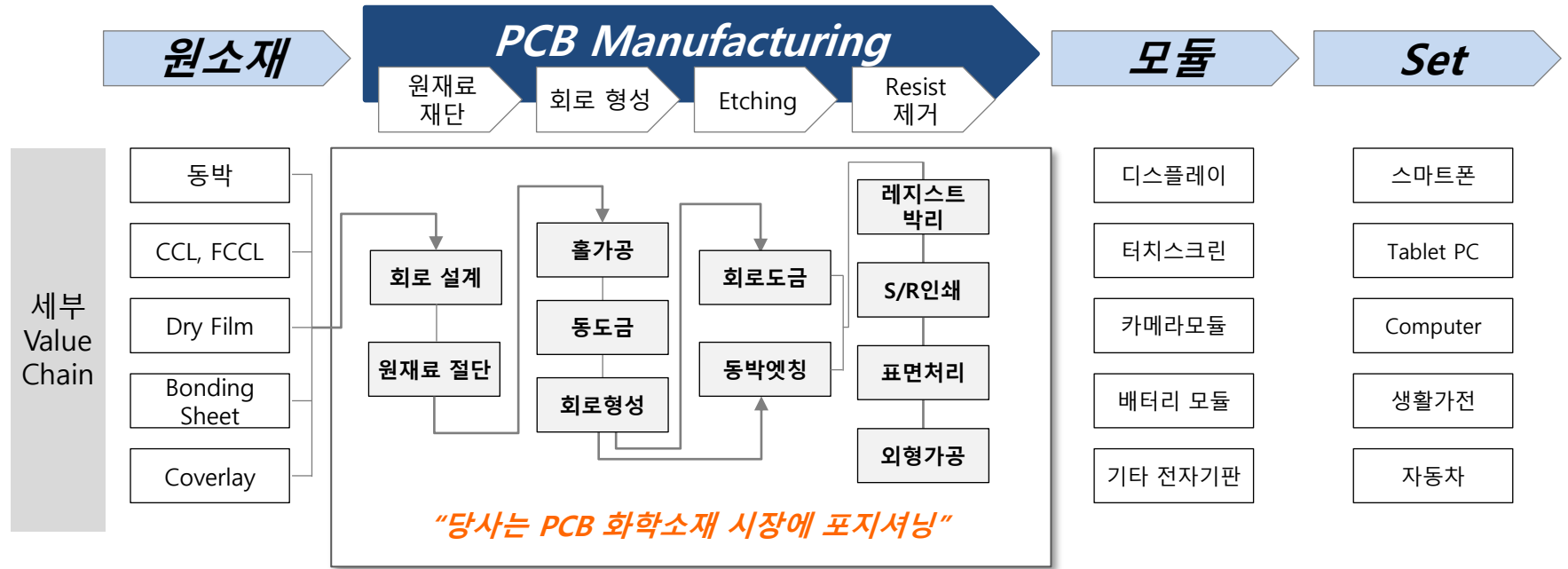
또한 본 자료는 미래에 대한 "예측정보"를 포함하고 있으며, 이러한 "예측정보"는 향후 경영환경의 변화 등에 따라 불확실성으로 인하여, 실제 경영현황 및 재무실적에 긍정적 또는 부정적으로 영향을 미칠 수 있습니다.

- 국내외 국가정책변경에 따른 세율 변동 (FTA, 관세, 법인세 등)
- 환율 및 이자 변동을 포함한 국내외 금융시장의 동향
- 주요 매출시장의 환경의 예상치 못한 급격한 변화
- 회사내의 전략적인 의사결정

이러한 불확실성으로 인해 회사의 실제 미래실적은 "예측정보"에 기재되거나 암시된 내용과는 중대한 차이가 있을 수 있습니다.



PCB Industry value chain



당사의 주요 포지셔닝은 PCB 화학소재이며 특히 부가가치가 높은 최종표면처리 및 화학동도금 Segment에서 주요 매출이 발생되고 있습니다.

주요고객사 (Major Customer)

*“주로 한국, 중국, 대만의 FPCB 회사들이 주요 고객사이며, 최근 한국의 PKG Substrate 제조사로 고객사 확대중”*

FPCB Customer	   
	   
	   
PKG Substrate	   

## Total Solution for Customer

와이엠티는 공정의 첫 단계인 세정, 박리제 부터 최종 표면처리 까지의 모든 화학소재 기술을 보유하고 있습니다. 이에 저희는 고객사 설비 특성에 맞는 Total chemical solution을 제공하고 있습니다.



### Final Finishing Chemical

#### **Soft ENIG Process**

- ✓ CF 300 Series
- ✓ MIKO Series

#### **ENIG Process**

- ✓ PEN Series
- ✓ MIKO Series

#### **ENEPIG Process**

- ✓ PEN Series
- ✓ ELP or ZEP Series
- ✓ IR Gold Series

#### **EPIG process**

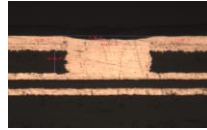
- ✓ ZEP Series
- ✓ IR Gold Series

#### **Immersion process**

- ✓ PROTIN Series

#### **Electrolytic gold process**

- ✓ HG 300 series
- ✓ SAU 10 series



### Copper plating chemical

#### **Electroless Copper plating**

- ✓ HVF Series
- ✓ MJH series

#### **Electrolytic Copper plating**

- ✓ BJ series
- ✓ HBJ Series(Half-fill)
- ✓ FSBJ Series(flash plating)
- ✓ ZEUS Series(Via-fill)



### Process Chemical

#### **DES Chemical**

- ✓ MSAP/SAP DFR Stripper
- ✓ MSAP/SAP Cu seed Etchant
- ✓ GMZ Series
- ✓ HWA Series

#### **Cleaner**

- ✓ FXC Series
- ✓ EQ Series

#### **Gold Recover**

#### **UBM Etchant**

#### **LAZ Process**



### New product for 5G

#### **No etching and roughness laminating pretreatment**

#### **Ultra low profile detachable thin copper foil**

#### **Positive Cu roughening**

#### **Process Nanotus®**

#### **Electroless Copper plating for LCP**

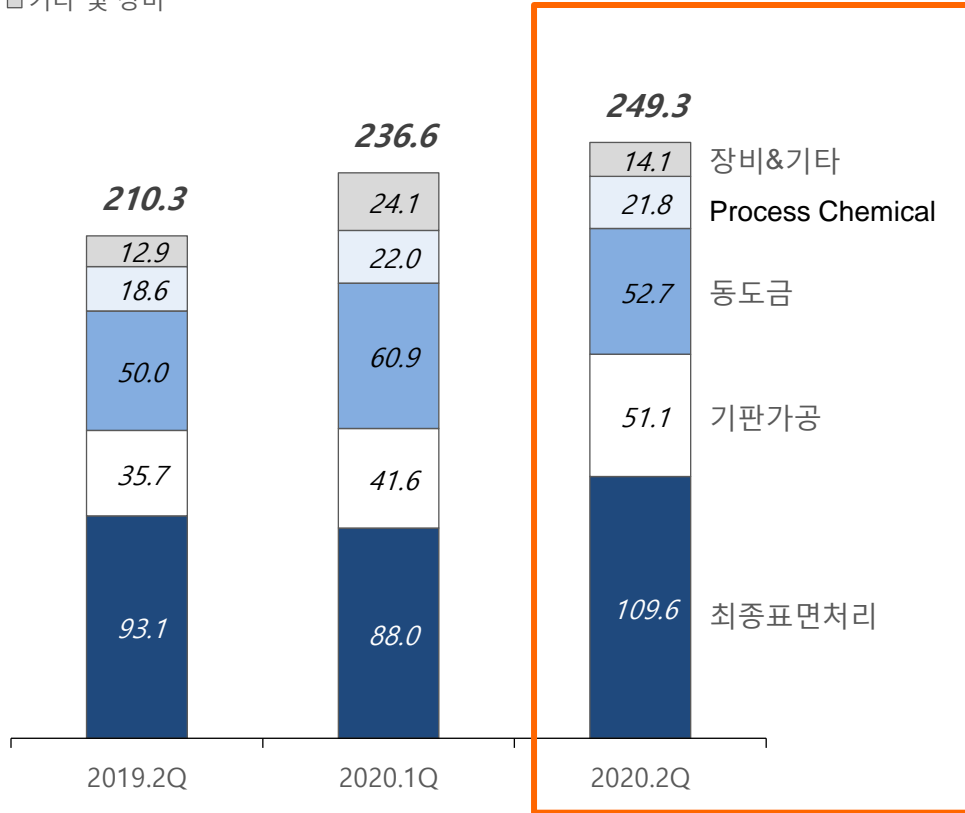
Domestic Market situation

신규 사업분야  
기존 사업분야

		"기존 사업영역" FPCB, RFPCB		"20년 신규진입분야" PKG		HDI		RIGID	
Major player	Domestic	<ul style="list-style-type: none"> <li>SEMCO</li> <li>BH Flex</li> <li>Youngpoong</li> <li>Daeduck</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>SEMCO</li> <li>Daeduck</li> <li>SIMTECH</li> <li>Korea Circuit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Daeduck</li> <li>LG Innoteck</li> <li>Korea Circuit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hyunwoo</li> <li>SEIL</li> </ul>				
	Global	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zhending Technology</li> <li>Career</li> <li>Unimicron</li> <li>Mektron</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>AT&amp;S</li> <li>Zhending Technology</li> <li>Ibiden</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>AT&amp;S</li> <li>Zhending Technology</li> <li>Ibiden</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Various</li> </ul>				
Process Chemical		<ul style="list-style-type: none"> <li>점유율 확대중</li> <li>Fine pattern 용 고부가가치 박리액 등 프로모션</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>19년 하반기 Major 고객사 첫 납품 시작으로 진입</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>박리 / 에칭 관련 매출 확대중</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> </ul>				
Cu Plating	Electroless	<ul style="list-style-type: none"> <li>국내 높은수준의 점유율 보유 (40% 이상 추정)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>자회사 외주를 통한 매출발생</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>국내 HDI 업체 프로모션 중</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> </ul>				
	Electro	<ul style="list-style-type: none"> <li>외주를 통한 양산</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Developing</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Developing</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> </ul>				
최종표면처리	Electroless	<ul style="list-style-type: none"> <li>금도금 분야 전세계 1위 점유율 확보 (50%이상)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>고객사 평가중</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Developing</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>일부 국내 고객사 거래중</li> </ul>				
	Electro	<ul style="list-style-type: none"> <li>자회사 외주를 통한 일부 매출 발생</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Developing</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Developing</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Developing</li> </ul>				

Sales Result

최종표면처리[금도금]      기판가공     (단위: 억원)  
 동도금      Process Chemical  
 기타 및 장비



• 20년 2분기 249.3억원 역대 최대 매출 달성

✓ 19년 동기대비 210.3억원 대비 18.2% 매출 상승

• Chemical 제품군의 지속적인 성장

- ✓ 최종표면처리 : 중국 시장 카메라모듈용 도금약품의 매출확대 / 특히 최대 고객사인 대만계 ZDT를 통하여 북미 보급형 모델에 적용중
- ✓ 동도금 : 북미 고객사 무선이러폰 물량 증가 및 베트남 내 동도금 약품 점유율 확대
- ✓ 기판가공 : 베트남 외주도금 물량 확대, 국내 동도금 외주물량 증가
- ✓ Process Chemical : Substrate PKG 고객사 진입으로 인한 전년 동기 대비 매출 상승

Income Statement

(단위:억원)

	제 22기 반기	매출비중	제 21기 반기	매출비중
I. 매출액	<b>485.9</b>	100%	388.6	100%
II. 매출원가	<b>314.8</b>	64.8%	240.0	61.8%
III. 매출총이익	<b>171.1</b>	35.2%	148.6	38.2%
판매비와 관리비	<b>72.1</b>	14.8%	53.5	13.8%
IV. 영업이익	<b>99.0</b>	20.4%	95.1	24.5%
금융수익	<b>26.3</b>	5.4%	10.2	2.6%
금융비용	<b>14.0</b>	2.9%	5.6	1.4%
기타수익	<b>2.0</b>	0.4%	7.9	2.0%
기타비용	<b>1.1</b>	0.2%	7.1	1.8%
지분법손익	<b>-0.9</b>	-0.2%	0.1	0.0%
V. 법인세차감전순이익	<b>111.3</b>	22.9%	100.6	25.9%
법인세비용	<b>8.5</b>	1.8%	22.1	5.7%
VI. 당기순이익	<b>102.8</b>	21.2%	78.5	20.2%

주요 수익성 지표

	22기 반기	21기 반기
영업이익률	20.4%	24.5%
순이익률	21.2%	20.2%
EBITDA (마진율)	127.4 (26.2%)	117.6 (30.3%)
총자산회전률	28.8%	28.9%



## Balance Sheet

(단위:억원)

	제 22기 반기	제 21기
자산		
현금성자산	540.8	417.5
매출채권	231.8	264.7
유형자산	630.2	608.6
기타자산	333.5	348.5
<b>자산총계</b>	<b>1,736.3</b>	<b>1,639.3</b>
부채		
매입채무	48.9	33.0
차입금	321.6	344.7
전환사채	146.4	140.4
기타부채	144.5	216.9
<b>부채총계</b>	<b>661.4</b>	<b>735.0</b>
자본		
자본금	37.0	37.0
자본잉여금	263.1	218.6
이익잉여금	608.5	531.3
기타자본	166.3	117.4
<b>자본총계</b>	<b>1,074.9</b>	<b>904.3</b>
부채와 자본계	1,736.3	1,639.3

## Cash Flow

(단위:억원)

	제 22기 반기	제 21기 반기
기초현금	417.5	276
영업활동으로 인한 현금흐름	172.1	64.8
순이익	102.8	78.5
감가상각비	23.1	18.3
대손상각비(환입)	-1.5	-11.3
이자비용	10.1	5.1
법인세비용	8.5	22.1
외화환산이익	-5.1	-4.4
자산부채의 변동	49.8	-37.4
투자활동으로 인한 현금흐름	-48.1	-51.8
유형자산의 증가	-43.3	-52.9
재무활동으로 인한 현금흐름	-4.9	15.6
자기주식의 처분	21.7	0
차입금 증감	-23	19.8
현금증감	119.1	28.6
환율변동효과	4.2	5.5
기말현금	540.8	310.1